

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

品名：BGA芯片返修工具套装

产品尺寸：133*8mm

净重：20g左右（净重）

配置：刀片*27、手柄*1

CPU拆卸工具套装

有弹性 有韧性 耐高温



笔型设计 轻盈小巧



十字开口设计

双夹口--操作方便



柔韧性十足

不易变形 不粘锡



快速分离锡点

轻松拆除手机主板等
各种小零件



手机除黑胶不伤主板

27片实用刀片轻松拆卸各种手机主板等小零件



CPU拆卸工具

拆芯片 清边胶 刮焊盘 高韧性 耐高温 不沾锡

送27片软刀片

